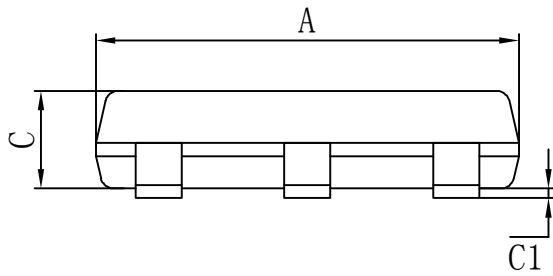
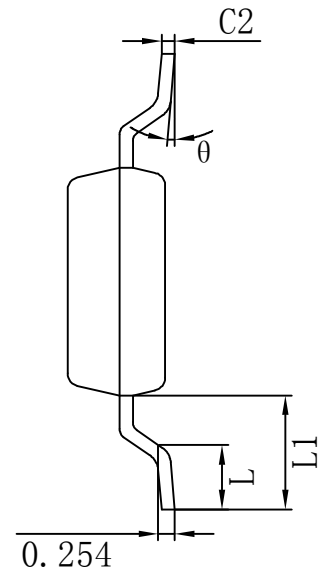
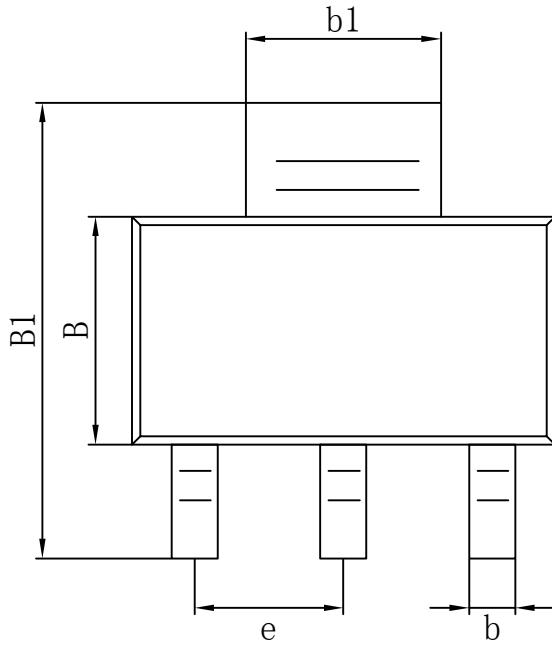




| 尺寸<br>标注 | 最小 (mm)     | 最大 (mm) | 尺寸<br>标注 | 最小 (mm) | 最大 (mm) |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|
| A        | 6.40        | 6.60    | C        | 1.45    | 1.65    |
| e        | 2.286 (BSC) |         | C1       | 0.03    | 0.15    |
| b        | 0.66        | 0.76    | C2       | 0.20    | 0.35    |
| b1       | 2.95        | 3.05    | L        | 0.76    | 1.16    |
| B        | 3.40        | 3.60    | L1       | 1.70    | 1.80    |
| B1       | 6.85        | 7.15    | $\theta$ | 0°      | 8°      |



|    |    |            |                 |  |         |    |
|----|----|------------|-----------------|--|---------|----|
| 制图 | 石艳 | 2017.09.22 | 名称              | 生效日期   |         |    |
| 审核 |    |            | SOT223<br>封装产品图 | 等级标记   | 重量      | 比例 |
| 批准 |    |            |                 |  |         |    |
| 单位 | mm |            | 图号              | 页数   | 第1页 共1页 |    |
| 镀涂 |    |            | C-0L-016        | <b>气派科技股份有限公司</b><br>China Chippacking Technology Co., Ltd |         |    |
|    |    |            | 版次              |  |         |    |